

2009年3月期
決算説明会

新日本無線株式会社



I . 2009年3月期決算について

決算サマリー



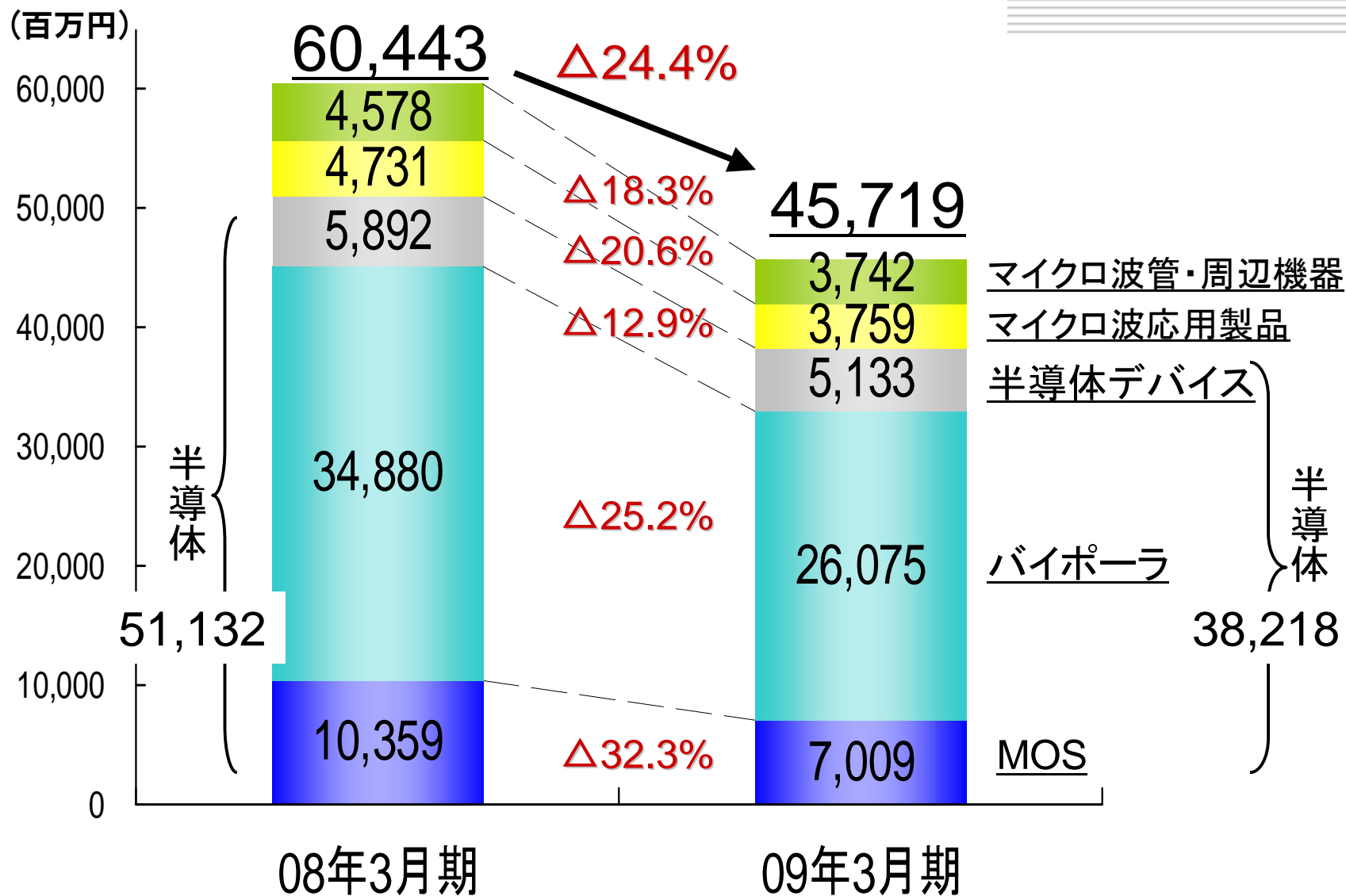
受注減、販売減、円高の影響により
通期業績予想の下方修正を期中2回行った。

<2009年3月期 通期連結業績予想修正の推移> (百万円)

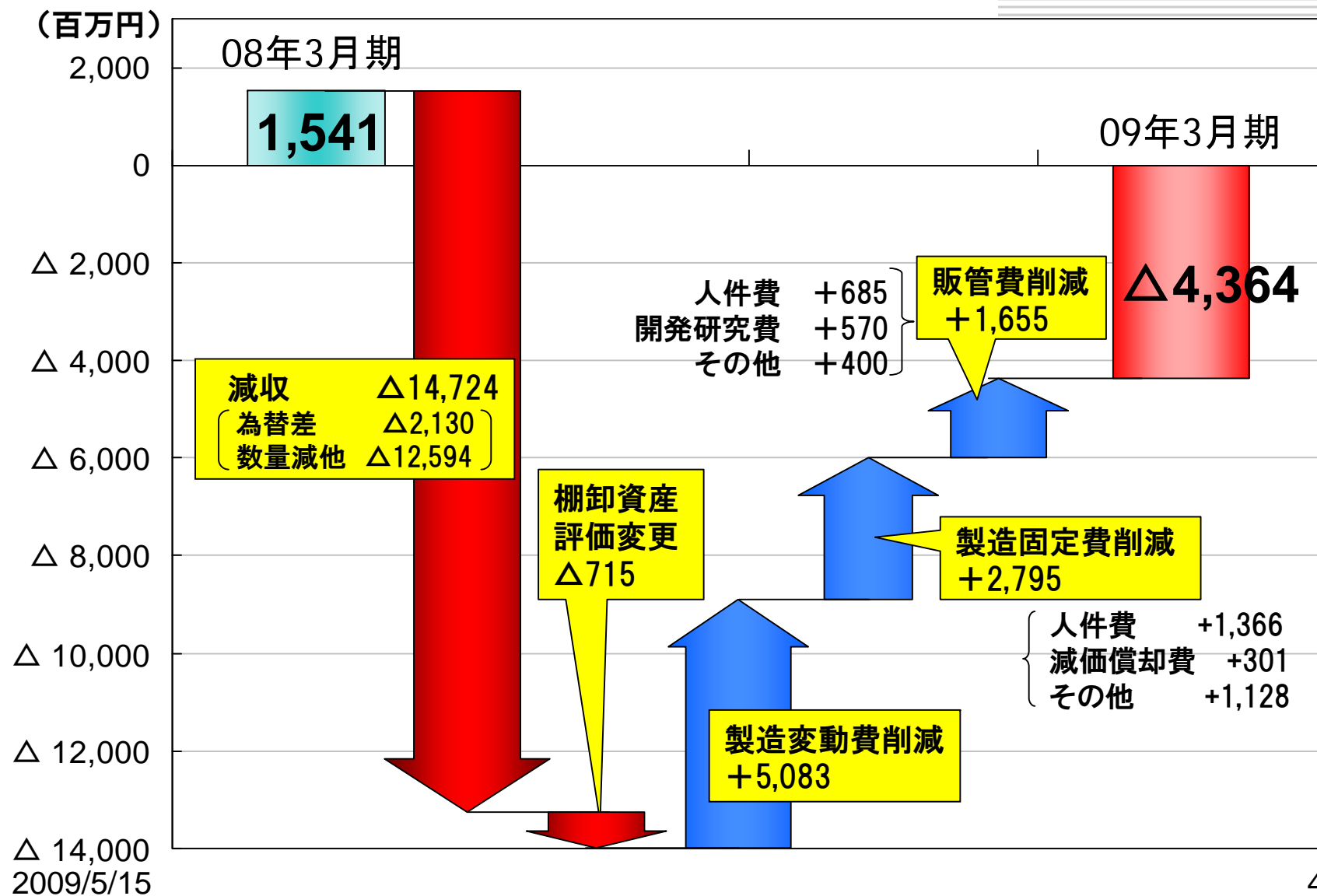
項目 \ 公表日	08年4月22日	08年10月14日	09年1月27日
連結売上高	61,500	54,500	46,500
営業損益	1,200	△1,300	△3,700
当期純損益	700	△900	△2,400

当社としては15年ぶりの赤字決算となった。

連結売上高



営業損益(連結)の分析



連結損益の推移



(百万円)

	営業損益	経常損益	当期純損益
08年3月期	1,541	1,042	434
09年3月期	△4,364	△4,531	△2,781

連結キャッシュ・フロー



(百万円)

	営業活動CF	投資活動CF	財務活動CF
08年3月期	2,183	△4,221	133
09年3月期	△250	△4,338	5,310

自己資本比率 08年3月期:43.9% 09年3月期:40.6%

費用削減実績



(百万円)

	08年3月期	09年3月期	削減額	削減率
人件費	22,098	20,047	2,051	9.3%
経費	10,983	9,017	1,966	17.9%
設備投資	4,173	2,459	1,714	41.1%
減価償却費	4,734	4,488	246	5.2%
研究開発費	6,098	5,833	265	4.3%

大幅な費用減によっても売上減による利益減をカバーできず最終赤字

Ⅱ . 2010年3月期事業計画の 概要について

事業計画の特徴(1)



- 第2四半期以降、市場の在庫調整終了分の回復を想定するが、本格的な需要回復は、当面期待できないと想定し、前年度並の販売計画とする。
- ただし、半導体デバイス(主にGaAs IC)は、販売拡大を見込む。
- 為替レート $¥95 = \text{US\$}1.00$
- 売上計画: 連結売上高450億円
(前年度比 $\Delta 1.6\%$)

事業計画の特徴(2)



製品部門別の販売計画の特徴

事業部門	前年度比	内容
マイクロ波管・周辺	△9.1%	官公需、民需ともに減
マイクロ波応用製品	△14.9%	衛星通信、地上通信ともに減
半導体	△0.5%	半導体デバイスを除き減
半導体デバイス	+17.7%	マイクロ波デバイス増
バイポーラ	△2.2%	受託生産販売減(NJR福岡)、 オペアンプ、電源用IC増
MOS	△2.0%	モータ用IC、DSP減、 オペアンプ、オーディオ用IC増

事業計画の特徴(3)



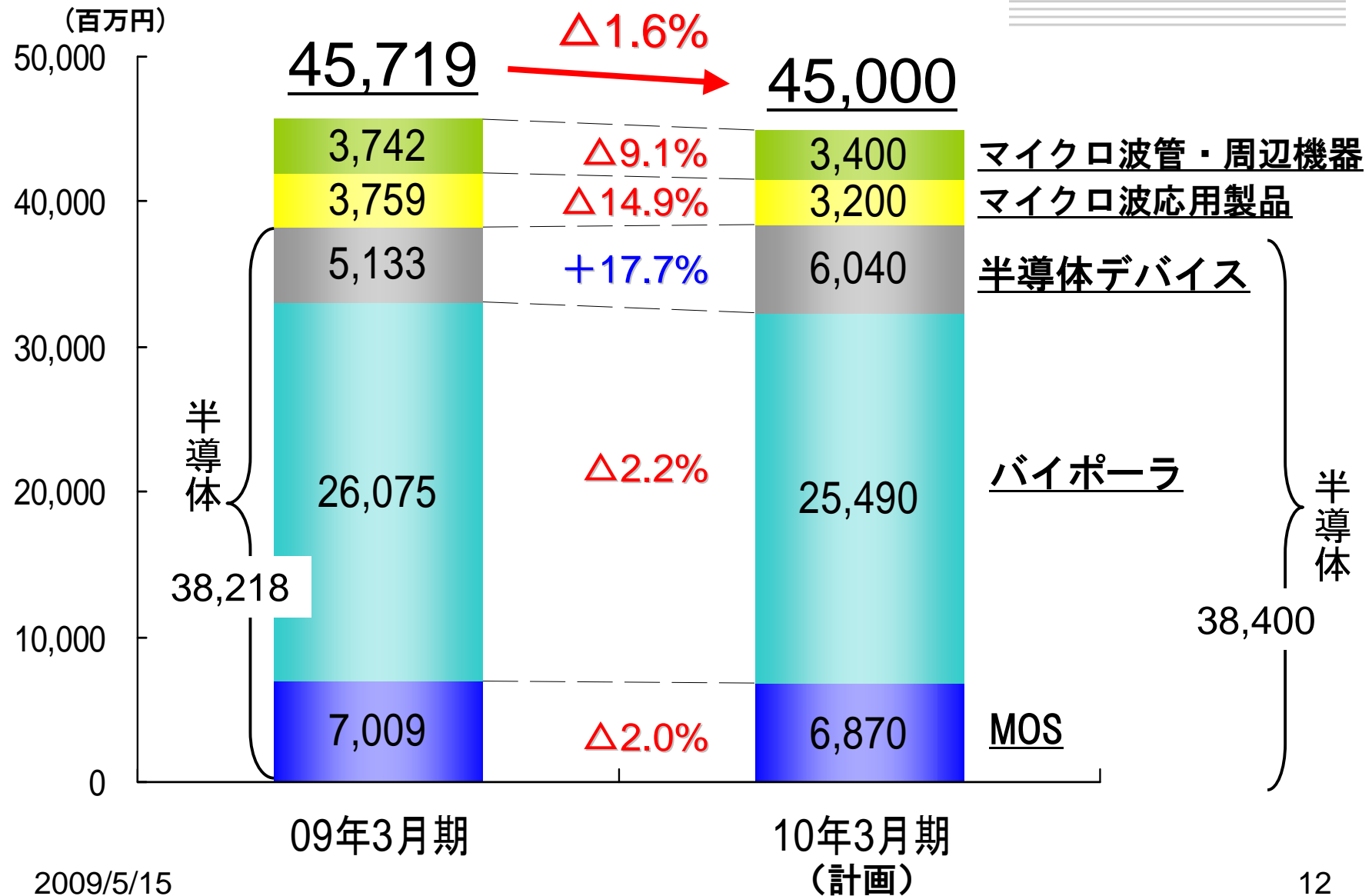
2009年度 費用削減計画

(百万円)

	09年3月期	10年3月期 (計画)	削減額	削減率
人件費	20,047	16,944	3,103	15.5%
経費	9,017	8,365	652	7.2%
設備投資	2,459	1,288	1,171	47.6%
減価償却費	4,488	3,722	766	17.1%
研究開発費	5,833	4,716	1,117	19.2%

売上高の急回復が見込めないため、
大幅な費用削減によって黒字化を狙う。

連結売上計画



連結損益計画(通期)



(百万円)

	営業損益	経常損益	当期純損益
09年3月期	△4,364	△4,531	△2,781
10年3月期 (計画)	450	250	120

Ⅲ. 2010年3月期事業計画達成 に向けた主要施策(実行中)

<大テーマ>

特別販売戦略チーム活動継続

- ◆ 電源用ICを中心とした集中的拡販
- ◆ 環境対応車への注力
- ◆ 中国地域拡販活動
- ◆ NJR上海直販強化
- ◆ 代理店との連携プレー強化

2008年度のチーム活動により
30億円以上の追加受注を獲得

工場(複数)について

- ◆ 位置づけ・役割の再定義
- ◆ 生産体制の見直し・変更
- ◆ 人員削減、人員の工場間シフト
- ◆ 生産コントロール部署の統廃合による
指揮命令の明瞭化・迅速化

UMCJとの生産協業のスタート

UMCJとの協業について



- UMCJの8インチ0.35ミクロンCMOSプロセスをベースに、当社のBCDプロセスを移植
- 新日本無線は素子設計を、
UMCJはプロセス設計を担う
- このプロセスを用いてパワーデバイス、
オートモーティブ用ICを設計・量産・販売
- 将来は0.18ミクロンプロセスへの移行も視野に

- ▶ 研究開発テーマの絞込み
- ▶ 基礎研究から開発への動きを加速
- ▶ 開発から実用化への動きを加速
- ▶ 関連する社内組織を統廃合
 - ・ 研究所を廃止し、開発部隊へマージ
 - ・ 開発部隊組織の一本化

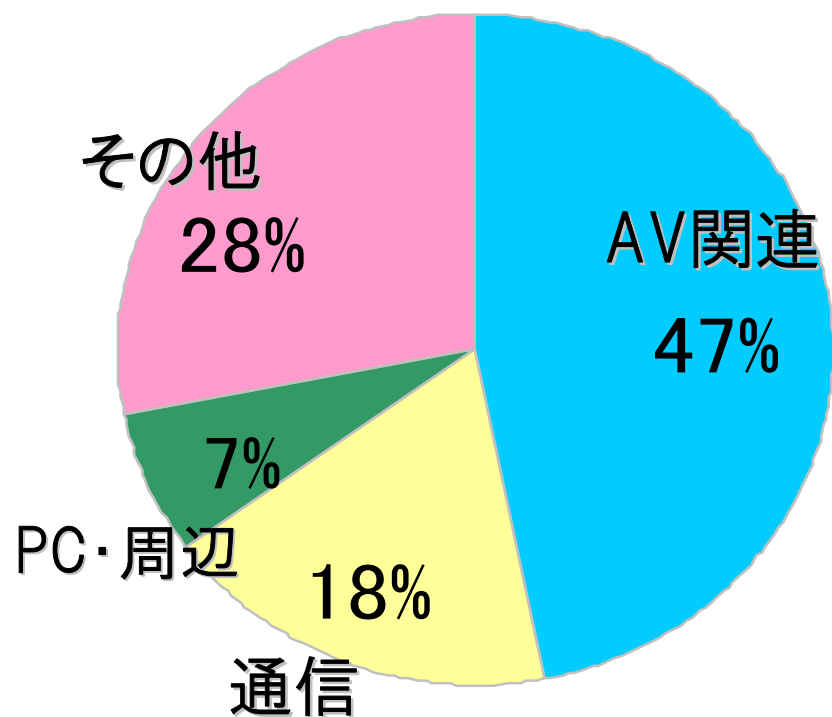
IV. 2010年3月期事業計画達成に 向けた主要施策（実行中）

<特徴ある強み>

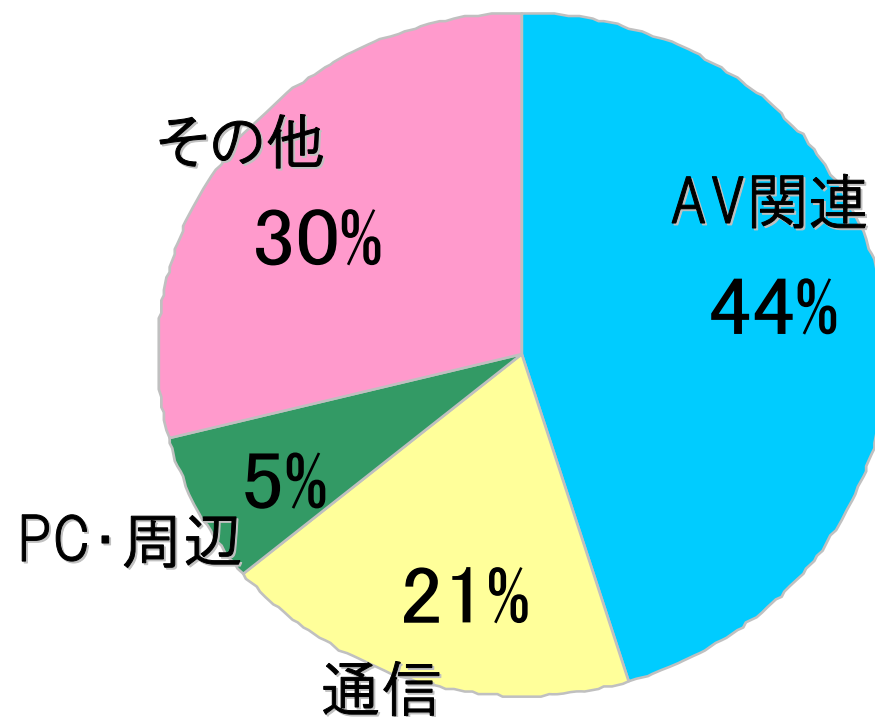
半導体販売分野別の状況(個別)



09年3月期実績



10年3月期計画



特徴ある強みポイント(1)



オペアンプの拡販

1. 車載用

高信頼度製品の拡大

2. 産業機器用

高精度・高安定オペアンプ

3. PKGの超小型化

<従来品> TVSP-8 /10
2.9 x 4.0 mm
t=1.0 mm(max)

超小型PKG

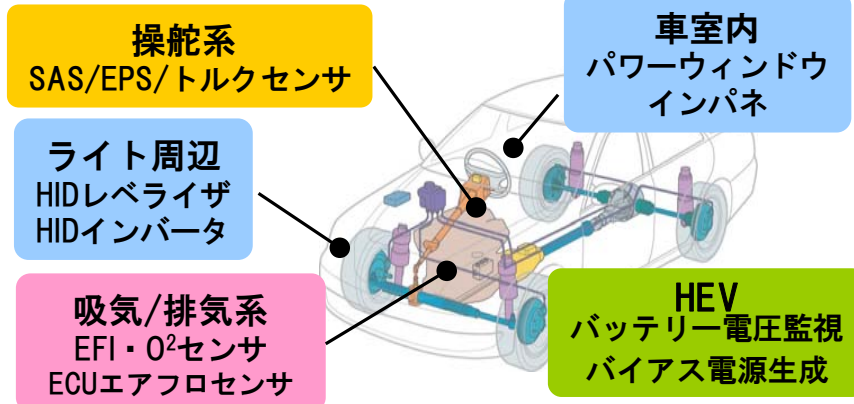


ESON-8
2.3X2.3mm
t=0.4 mm

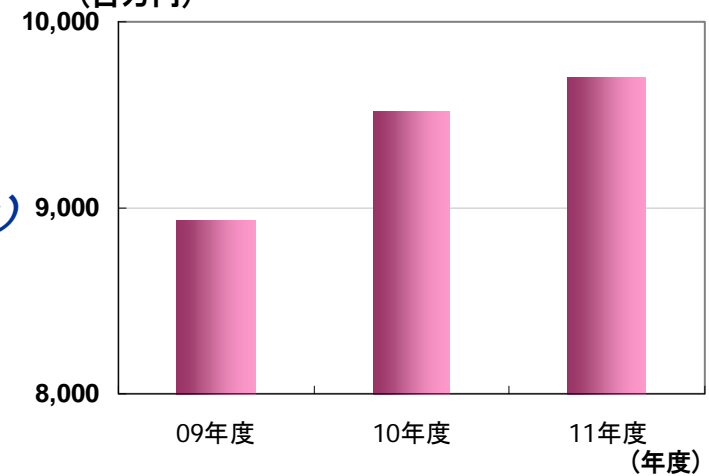


ESON-8
2.0X2.0mm
t=0.4 mm

実装面積 (従来品比)
50%以下実現!



(百万円) <オペアンプ販売計画>



特徴ある強みポイント(2)



ハイエンドオーディオ機器向けオペアンプ

MUSESシリーズと銘打ち

当月より量産開始



<特徴>

- ✔ 回路技術、パタンレイアウト、パッケージ組立て
用材料および組立て手法などのノウハウ多数
- ✔ シリーズ化し、高音質をうたって幅広く展開する。
既にハイエンドオーディオ機器専門メーカーから受
注確定

GaAs IC

*世界最小・最薄・最高機能製品で
海外へも販売拡大中!*

- ▶ NTT Docomo携帯電話機向け シェア約70%達成
- ▶ 中国の独自規格にも対応済(受注急増中)
- ▶ GSMハイエンド市場(2G+3Gマルチ)でも
最小・最薄の製品を実現

光半導体デバイス

世界最小リフレクタで他社を圧倒！

これまでも当社製品が

世界最小

1.3×1.6×0.6mm

更に小型化！

1.0x1.4x0.6mm

韓国大手携帯電話機
メーカーのカメラモジュ
ールに採用済

採用機種増加へ
他の大手メーカーへ
販売拡大

半導体パッケージ組立ラインを革新

半導体パッケージ子会社(佐賀エレクトロニクス(株))
にて多品種少量生産向けのラインを確立

従来、パッケージ毎に構築していた生産ラインを、
共通のプラットフォームで生産できるという特徴が強み

- ・開発費用/工期の短縮
- ・量産効果や経験曲線の早期取得
- ・高い設備維持力
- ・生産変動への高い対応力

特徴ある強みポイント(6)



マイクロ波管事業において、レーダー市場に加え
X線応用製品の開発、販売を加速

海外X線応用市場

ライナック用電子管・電子銃



電子銃



電子管

応用例



医療用ライナック



産業用ライナック

特徴ある強みポイント(7)

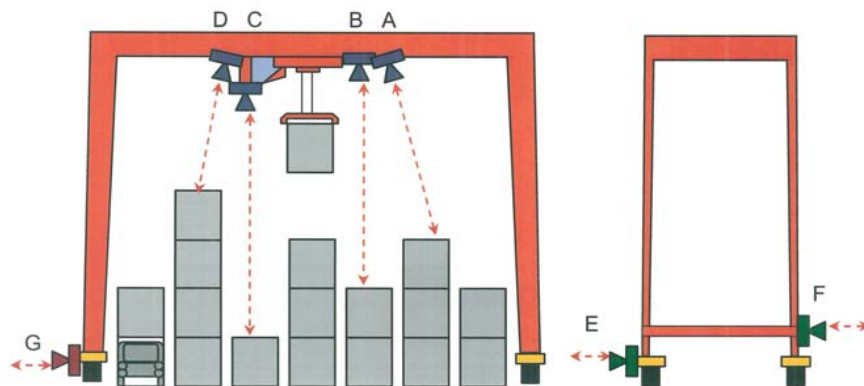


☆マイクロ波センサーコンポーネント事業において
K帯FM-CWレーダモジュールの応用展開進展
○トランスファークレーン安全監視システム
(港湾コンテナクレーンに搭載)


【特長】

(従来の超音波／レーザ 距離センサーとの比較)

- ① 天候(風雨・霧・空気密度)による影響を受けにくい
- ② 対象物体の形状にかかわらず、安定した距離測定が可能
- ③ より長距離の測定が可能



09年3月3日 (株)商船三井様
プレスリリースより

A decorative horizontal bar is positioned at the top of the slide. It features a gradient from light gray to dark gray, with a black section on the right side. Below the black section are several thin, horizontal white lines.

V. 中期的な新デバイスの 研究開発について

デジタル電源制御ICの開発・量産へ！

・デジタル電源のメリット

高速スイッチング制御
回路の簡素化
電圧と電流の同時制御
高速通信機能付加 等

・開発状況

08年度 基礎開発
09年度 量産立上げ

デジタル電源制御ICの
市場規模予測

2007年度	2010年度
140	400
百万US\$	百万US\$

新デバイスの研究開発(2)

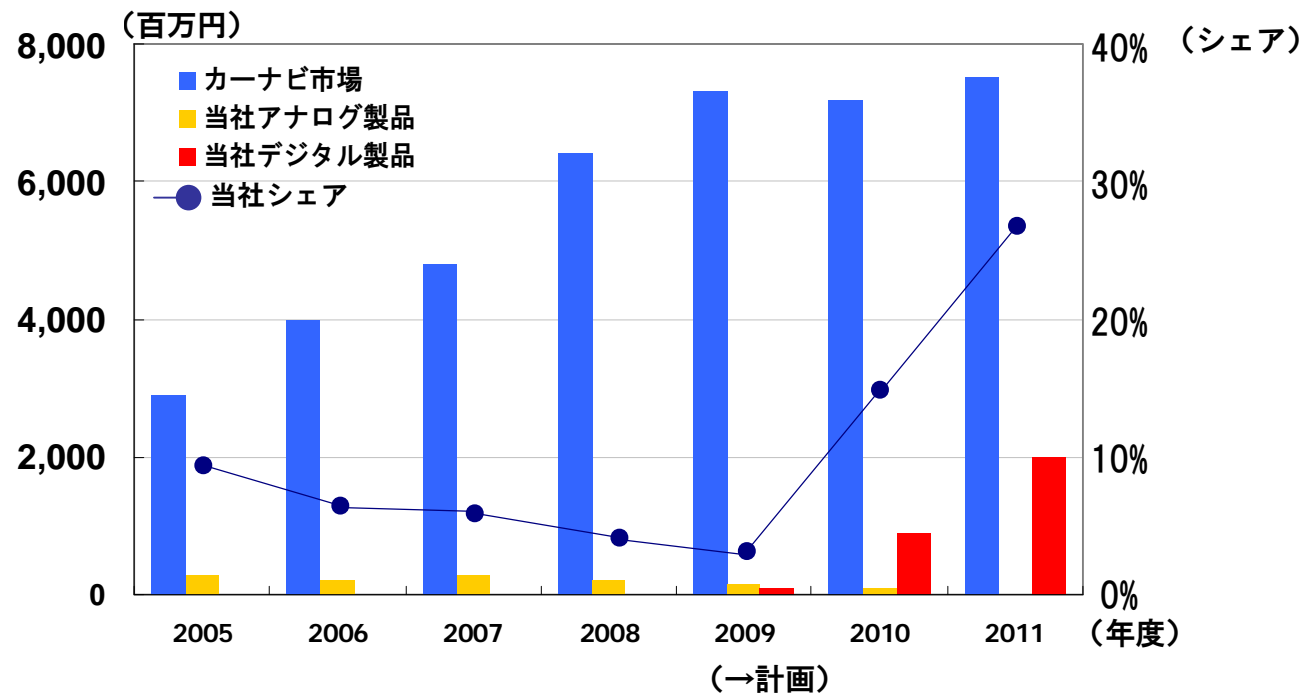


デジタルビデオデコーダの開発

アナログとデジタルの設計技術の融合

応用分野: 主にカーナビゲーション機器向け

開発目標: 2009年 サンプル出荷 2010年 量産開始



新デバイスの研究開発(3)



微弱無線トランシーバIC (300MHz帯)

・応用分野

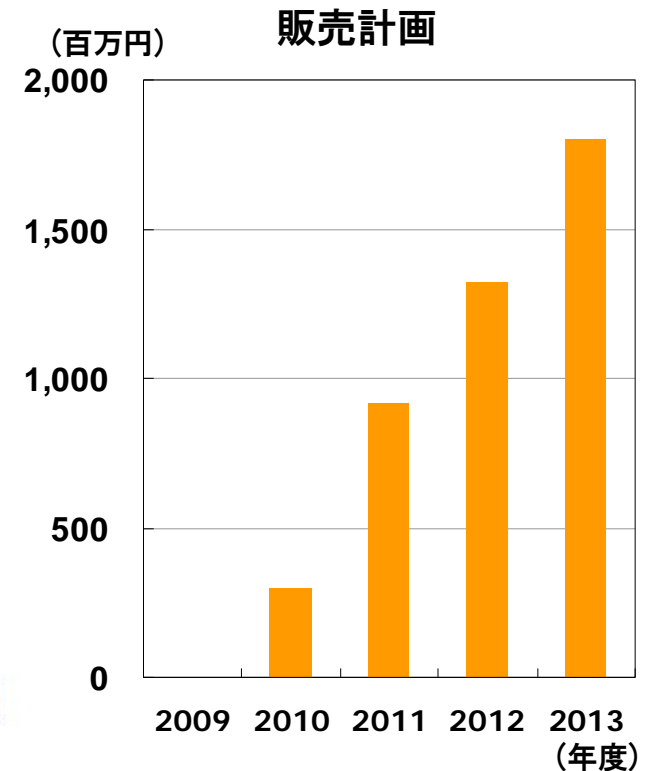
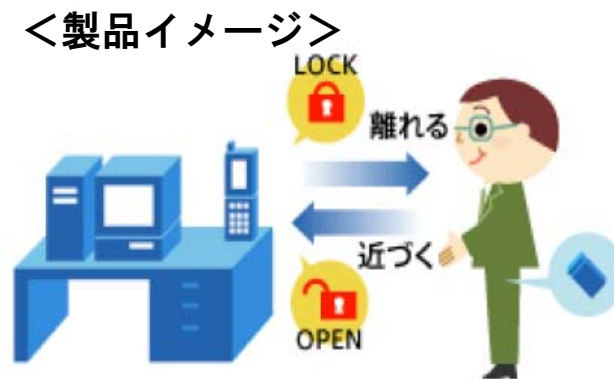
携帯電話やパソコンの盗難・紛失や不正使用を防御

・開発体制

大手モジュールメーカーとの共同研究開発
(無線性能、システム性能の相互検証)

・開発目標

2009年
サンプル出荷
2010年
量産開始



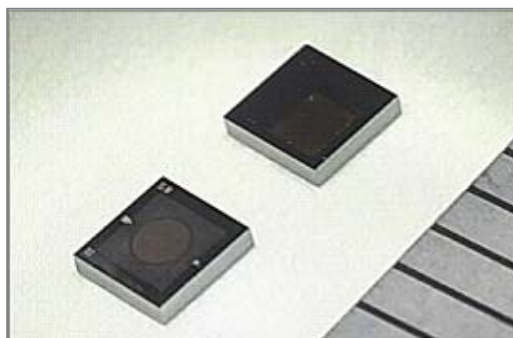
新デバイスの研究開発(4)



MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

開発中の デバイス	電子スイッチ	Siマイクロフォン
	誤動作のないスイッチ	より高性能を目指した マイクロフォン
応用分野	ビデオカメラ・デジカメ・ ゲーム機等	携帯電話機・パソコン・ ICレコーダ等
製品開発予定	2010年度	2011年度

<試作品(MEMSマイク)>



新デバイスの研究開発(5)



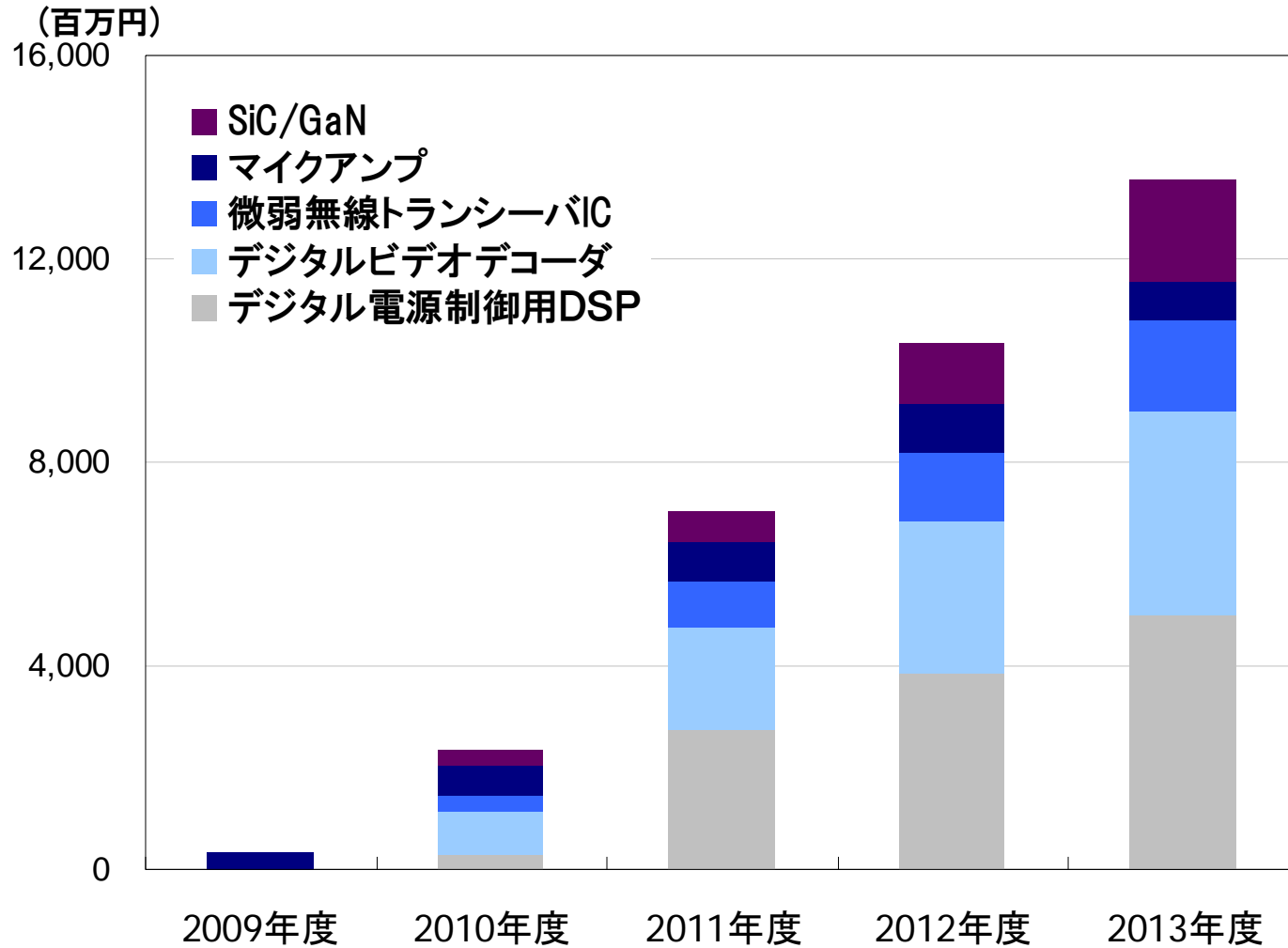
ワイドバンドギャップ半導体デバイスの開発

SiCデバイス	GaNデバイス
<ul style="list-style-type: none">• 研究から開発・実用化フェーズへ展開• 当社独自のデバイス構造とプロセスが強み• 高耐圧、大電力、高周波の特徴をいかしてゆく	
<ul style="list-style-type: none">• 当社の実績豊富な船舶レーダ向けの試作品完成済み• SBD開発強化	<ul style="list-style-type: none">• 電力分野への応用可能性を共同研究開発中
<ul style="list-style-type: none">• 2013年頃には20億円程度の売上を狙う	

新デバイスの研究開発(6)



開発案件の販売見込額合計 (計画)



VI. 品質経営、環境経営、 その他について

品質経営



トヨタ自動車(株)広瀬工場様より 2年連続品質優秀賞を受賞 (2009年4月)

<トヨタ自動車(株)様より>

当社オペアンプ、電源用ICが対象で、2008年度納入製品の不良がゼロであったことが評価された



<富士通テン(株)様より>



富士通テン(株)様より 品質優秀賞を受賞(2009年3月)

当社の半導体製品が、3年連続で品質評価基準を全て満たしたことが評価された

- ・ 海外も含めグループ企業へ展開
- ・ 環境配慮型製品の開発促進
 - 半導体パッケージの鉛フリー（完了）
 - 半導体パッケージのハロゲンフリー
(2009年度中完了)
 - CdSセル代替シリコン照度センサ
 - パワーセーブ型各種IC
- ・ 当社独自の環境月間活動
- ・ 部材・設備のグリーン調達

企業理念と企業像



新日本無線

私たちの使命

Corporate Mission

**社会の期待と顧客の期待の適合における
中心的役割を果たすことによって
健全な社会成長の一助となる**

独創的「マイクロエレクトロニクスとマイクロウェーブ」技術を軸とした
最適部品の提供を通してコーポレートミッションを実現する

私たちの未来

Our Vision 2017

新日本無線のチャレンジ —— 2017年の企業像

- アナログIC事業、デジタルIC事業、化合物半導体事業
マイクロ波製品事業それぞれが
世界に通用するブランドとして確立しています
- 躍動感のある若々しい会社とイメージされています

顧客
業界トップクラスの
総合的IC/ODMの提供による
ご満足を実現しています

地域社会
地域活性化につながる
創造的活動による
ご満足を実現しています

従業員
成長の舞台につながる
高いモチベーションによる
ご満足を実現しています

取引先
一歩の取引先であることによる
ご満足を実現しています

株主
企業の社会的責任の
履行による
ご満足を実現しています

新日本無線

目 的

経営の意思決定の迅速化

権限と責任の明確化による

業務執行体制を強化

新体制

2009年6月26日開催予定の株主総会
およびその後の取締役会にて正式決定
される予定

本資料ご使用に当たり



- この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは大きく異なる場合があります。予めご承知の上、ご利用下さいますようお願い申し上げます。

本日は、ご清聴ありがとうございました。

新日本無線株式会社